

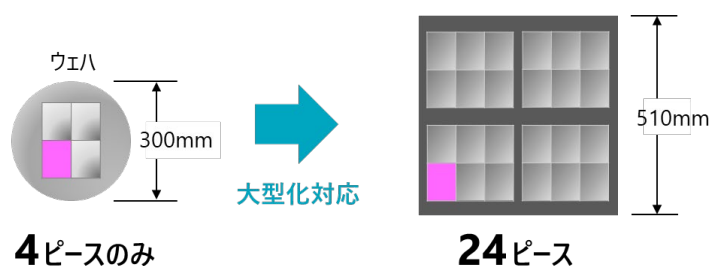
次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画 —— 各社との連携を通じて、新規プロセスの構築に貢献 ——

リンテックは、次世代半導体パッケージのコンソーシアム「JOINT3」に参画します。

JOINT3は、材料・装置・設計企業が共創することで、パネルレベル有機インターポザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速することを目的に、株式会社レゾナック(代表取締役社長 CEO:高橋秀仁、以下、レゾナック)により設立された共創型評価プラットフォームです。

JOINT3には、半導体材料・装置・設計の分野において世界トップクラスの企業が集結し、515 x 510mmサイズのパネルレベル有機インターポザー試作ラインを用いて、パネルレベル有機インターポザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を推進します。これまで独自の自社技術を生かして、半導体後工程で使用される各種高機能テープや関連装置を手掛けてきた当社では現在、次世代パッケージに関わる技術の確立にも注力しており、その一環として今回、このコンソーシアムに参画することにしました。

昨今、市場が急拡大している生成AIや自動運転を実現する次世代半導体においては、後工程のパッケージング技術がキーテクノロジーのひとつとなっています。なかでも、複数の半導体チップを並列に配置し、インターポザー(中間基板)を介して接続し実装した 2.xD パッケージは、データ通信の容量増加、高速化に伴い、さらに需要が拡大する見込みです。インターポザーは、半導体の性能向上に伴いそのサイズが大型化しており、シリコンインターポザーから有機材料を用いた有機インターポザーへの移行が進んでいます。製造方法に関しては、円形ウェハから四角片を切り出す手法が主流ですが、インターポザーのサイズが大型化することで、ウェハあたりのインターポザーの取り数が減少するという課題が生じています。この課題に対処するため、円形のウェハ形状から四角いパネル形状へ変更し、インターポザーの取り数を増加させる製造プロセスが注目されています。



JOINT3 において、当社はこれまで培ってきた粘着技術や装置技術をベースに、他の参画企業と連携しながら新たな独自技術の創出にも取り組み、技術と技術を高次元で融合させていくことで、半導体実装技術のさらなる発展に貢献していきたいと考えています。

■リリース内容に関する報道関係者の方からのお問い合わせ

リンテック株式会社 広報・IR 室

〒173-0001 東京都板橋区本町 23-23 TEL. (03)5248-7741 FAX. (03)5248-7754 担当:阿部、高津

本リリースに使用している外観イメージデータは、<https://www.lintec.co.jp/pub/> からダウンロードいただけます。



名称	JOINT3 (JOINT : Jisso Open Innovation Network of Tops)
目的	参画企業との共創により、パネルレベル有機インターポザーに適した材料・装置・設計ツールの開発を加速
参画企業 アルファベット順	27 社(2025 年 9 月 3 日時点) 株式会社レゾナック、AGC 株式会社、Applied Materials, Inc.、ASMPT Singapore Pte. Ltd.、Brewer Science, Inc.、キヤノン株式会社、Comet Yxlon GmbH、株式会社荏原製作所、古河電気工業株式会社、株式会社日立ハイテク、JX 金属株式会社、花王株式会社、Lam Research Salzburg GmbH、リンテック株式会社、メック株式会社、株式会社ミツトヨ、ナミックス株式会社、ニッコー・マテリアルズ株式会社、奥野製薬工業株式会社、Synopsys, Inc. (日本窓口：アンシス・ジャパン株式会社)、東京エレクトロン株式会社、東京応化工業株式会社、TOWA 株式会社、株式会社アルバック、ウシオ電機株式会社、株式会社図研、3M Company
拠点	・先端パネルレベルインターポザーセンター「APLIC (Advanced Panel Level Interposer Center)」 (茨城県結城市、レゾナック下館事業所(南結城)内) ・パッケージングソリューションセンター(神奈川県川崎市)
活動内容	・パネルレベル(515 x 510mm)の試作ラインを用いて、有機インターポザー向けの材料・装置・設計ツールを開発 ・材料・装置メーカーが共通の試作品を作製し、共創により開発を進める ・技術・装置メーカーが JOINT3 を「練習場」とし、パネルレベル有機インターポザーに関する技術を磨く



APLIC 外観 (イメージ)

【Resonac(レゾナック)について】

レゾナックは、半導体・電子材料、モビリティ、イノベーション材料、ケミカル等を展開し、川中から川下まで幅広い素材・先端材料テクノロジーを持つ機能性化学メーカーです。2023年1月に昭和電工と旧日立化成が統合し、誕生しました。社名の「Resonac」は、英語の「RESONATE:共鳴する・響き渡る」と、Chemistry の「C」の組み合わせです。レゾナックは「共創型化学会社」として、共創を通じて持続的な成長と企業価値の向上を目指しています。2024年度の売上高は約1兆4千億円、うち海外売上高が56%を占め、世界24の国や地域にある製造・販売拠点をグローバルに事業を展開しています(2025年2月時点)。詳しくはウェブサイトをご覧ください。

株式会社レゾナック・ホールディングス <https://www.resonac.com/jp/>